SN74UVP1G04 低消費電力 シングル インバータ ゲート

1 特長

- 0.63V～3.6V の電源電圧範囲で低電圧動作に対応
- 広い動作温度範囲:-40℃ ～ 125℃
- 低消費電力
  - I_{CC} = 10nA (標準値)
  - 入力リーク電流 I_I = 3nA (標準値)
  - 出力オフ状態リーク電流 I_{OZ} = 100nA (標準値)
  - 部分的パワーダウン I_{OFF} 0.2μA (標準値)
- 3.6V 許容入力で降圧変換に対応
- 9.5ns (3.3V 時) の最大 t_{pd}
- AUP ファミリとのドロップイン互換性、および V_{CC} が 0.8V から 0.63V に拡張

2 アプリケーション

- PC とノート PC
- データ センター
- ビル オートメーション
- 携帯電話 / スマートフォン
- ウェアラブル
- 有線ネットワーク

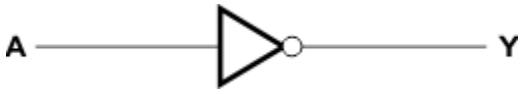
3 説明

SN74UVP1G04 デバイスは、ブール関数 Y = $\overline{A}$ を実行する低消費電力のシングルインバータです。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
SN74UVP1G04	DBV (SOT-23、5)	2.90mm × 1.60mm
	DCK (SC-70、5)	2.00mm × 1.25mm
	DRY (USON、6)	1.45mm × 1.00mm
	DSF (X2SON、6)	1.00mm x 1.00mm
	DPW (X2SON、5)	0.80mm × 0.80mm

(1) 詳細については、セクション 11 を参照してください。
(2) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



概略回路図

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....1
2 アプリケーション.....1
3 説明.....1
4 ピン構成および機能.....3
5 仕様.....4
5.1 絶対最大定格.....4
5.2 ESD 定格.....4
5.3 推奨動作条件.....4
5.4 熱に関する情報.....5
5.5 電気的特性.....6
5.6 スイッチング特性.....6
6 パラメータ測定情報.....8
7 詳細説明.....9
7.1 概要.....9
7.2 機能ブロック図.....9
7.3 機能説明.....9
7.4 デバイスの機能モード.....9
8 アプリケーションと実装.....10
8.1 使用上の注意.....10
8.2 代表的なアプリケーション.....10
8.3 電源に関する推奨事項.....10
8.4 レイアウト.....11
9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....13
9.1 ドキュメントのサポート.....13
9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....13
9.3 サポート・リソース.....13
9.4 商標.....13
9.5 静電気放電に関する注意事項.....13
9.6 用語集.....13
10 改訂履歴.....13
11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....14

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 ピン構成および機能

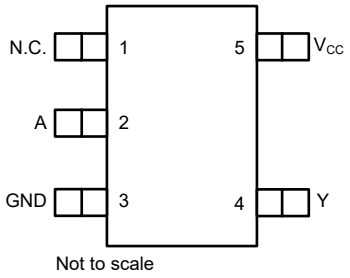


図 4-1. DBV または DCK パッケージ、5 ピン SOT-23 または SC-70 (上面図)

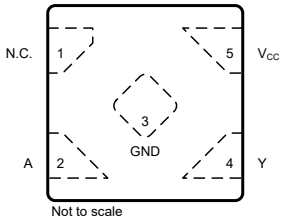


図 4-2. DPW パッケージ、5 ピン X2SON (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ(1)	説明
名称	DPW、DBV、DCK		
N.C.	1	—	内部接続なし
A	2	I	入力 A
GND	3	G	グランド ピン
Y	4	O	出力 Y (プッシュプル)
VCC	5	P	パワー ピン

(1) I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源

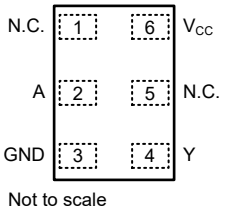


図 4-3. DRY または DSF パッケージ、5 ピン USON または X2SON (上面図)

表 4-2. ピンの機能

ピン		タイプ(1)	説明
名称	DSF、DRY		
N.C.	1、5	—	内部接続なし
A	2	I	入力 A
GND	3	G	グランド ピン
Y	4	O	出力 Y (プッシュプル)
VCC	6	P	パワー ピン

(1) I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	6	V
V_I	入力電圧範囲(2)		-0.5	6	V
V_O	出力電圧範囲(2)		-0.5	V_{CC} + 0.5	V
I_{IK}	入力クランプ電流	V_I < 0V		-50	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	V_O < 0V		-50	mA
I_O	連続出力電流			±50	mA
I_O	V_{CC} または GND を通過する連続出力電流			±100	mA
T_J	接合部温度		-65	150	°C
T_{stg}	保存温度		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、また「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件においても、本デバイスが動作することを暗黙に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外でも、絶対最大定格の範囲内であれば、一時的な動作によってデバイスが損傷するとは限りませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
(2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 (2)	±1000	

(1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		0.63	3.6	V
V_I	入力電圧		0	5.5	V
V_O	出力電圧		0	5.5	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	V_{CC} = 0.63V～0.77V	0.65 x Vcc		V
		V_{CC} = 0.72V～0.88V	0.65 x Vcc		
		V_{CC} = 0.9V～1.1V	0.65 x Vcc		
		V_{CC} = 1.08V～1.32V	0.65 x Vcc		
		V_{CC} = 1.35V～1.65V	0.65 x Vcc		
		V_{CC} = 1.62V～1.98V	0.65 x Vcc		
		V_{CC} = 2.3V～2.7V	1.7		
		V_{CC} = 3.0V～3.6V	2		

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.3 推奨動作条件 (続き)

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

仕様	説明	条件	最小値	最大値	単位
V_{IL}	Low レベル入力電圧	V_{CC} = 0.63V～0.77V		0.35 x Vcc	V
		V_{CC} = 0.72V～0.88V		0.35 x Vcc	
		V_{CC} = 0.9V～1.1V		0.35 x Vcc	
		V_{CC} = 1.08V～1.32V		0.35 x Vcc	
		V_{CC} = 1.35V～1.65V		0.35 x Vcc	
		V_{CC} = 1.62V～1.98V		0.35 x Vcc	
		V_{CC} = 2.3V～2.7V		0.7	
		V_{CC} = 3.0V～3.6V		0.8	
I_{OH}	High レベル出力電流	V_{CC} = 0.63V		-0.2	mA
		V_{CC} = 0.72V		-0.5	
		V_{CC} = 0.9V		-0.7	
		V_{CC} = 1.08V		-1.1	
		V_{CC} = 1.35V		-1.7	
		V_{CC} = 1.62V		-1.9	
		V_{CC} = 2.3V		-3.1	
		V_{CC} = 3.0V		-4	
I_{OL}	Low レベル出力電流	V_{CC} = 0.63V		0.2	mA
		V_{CC} = 0.72V		0.5	
		V_{CC} = 0.9V		0.7	
		V_{CC} = 1.08V		1.1	
		V_{CC} = 1.35V		1.7	
		V_{CC} = 1.62V		1.9	
		V_{CC} = 2.3V		3.1	
		V_{CC} = 3.0V		4	
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート	V_{cc} = 0.65V ～ 3.6V		200	ns/V
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	°C

5.4 熱に関する情報

パッケージ	ピン	熱評価基準(1)						単位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
DBV (SOT-23、5)	5	298.6	240.2	134.6	114.5	133.9	該当なし	°C/W
DCK (SC-70、5)	5	314.4	128.7	100.6	7.1	99.8	該当なし	°C/W
DRY (USON、6)	6	554.9	385.4	388.2	159.0	384.1	該当なし	°C/W
DSF (X2SON、6)	6	407.1	232.0	306.9	40.3	306.0	該当なし	°C/W
DPW (X2SON、5)	5	291.8	224.2	245.8	31.4	245.6	195.4	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
V_{OH}	I_{OH}= -20μA	0.63V ～ 3.6V	V_{CC} - 0.1			V
	I_{OH}= -0.7mA	1.0V	0.65			
	I_{OH}= -1.1mA	1.2V	0.97			
	I_{OH}= -1.7mA	1.5V	1.24			
	I_{OH}= -1.9mA	1.65V	1.4			
	I_{OH}= -3.1mA	2.3V	1.99			
	I_{OH}= -3.5mA	2.7V	2.35			
	I_{OH}= -4mA	3V	2.67			
V_{OL}	I_{OL}= 20μA	0.63V ～ 3.6V			0.15	V
	I_{OL}= 0.7mA	1.0V			0.35	
	I_{OL}= 1.1mA	1.2V			0.25	
	I_{OL}= 1.7mA	1.5V			0.23	
	I_{OL}= 1.9mA	1.65V			0.23	
	I_{OL}= 3.1mA	2.3V			0.26	
	I_{OL}= 3.5mA	2.7V			0.27	
	I_{OL}= 4mA	3V			0.29	
I_I	V_I = V_{CC} または GND	V_{CC} = 0V ～ 3.6V		±0.003	±0.5	μA
I_{OFF}	V_I または V_O = V_{CC}	V_{CC} = 0V		±0.2	±1	μA
I_{CC}	V_I = V_{CC} または GND、I_O = 0	V_{CC} = 0.63V～3.6V		0.01	1.4	μA
ΔI_{CC}	1 つの入力は V_{CC} - 0.6V、その他の入力は V_{CC} または GND	3.3V			60	μA
ΔI_{CC}	1 つの入力は V_{CC} - 0.6V、その他の入力は GND から V_{CC} にスイープ	3.3V			1800	μA
C_I	V_I = V_{CC} または GND	3.3V		4.4		pF
C_O	V_O = V_{CC} または GND	3.3V		2.6		pF

5.6 スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、T_A = 25℃で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
t_{pd}	A	Y	C_L = 5pF	0.7V ± 0.07V			132	ns
				0.8V ± 0.08V			83	ns
			C_L = 10pF	1.0V ± 0.1V			29	ns
				1.2V ± 0.12V			11	ns
			C_L = 15pF	1.5V ± 0.15V			7	ns
				1.8V ± 0.18V			5	ns
			C_L = 30pF	2.5V ± 0.2V			6	ns
				3.3V ± 0.3V			5	ns

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

自由空気での動作温度範囲内、T_A = 25℃で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」を参照

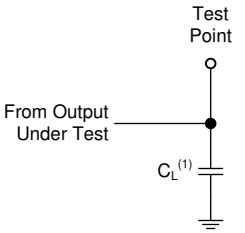
パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷条件	V_{CC}	最小値	標準値	最大値	単位
C_{pd}			f = 10MHz	0.7V		5		pF
				0.8V		6		pF
				1.0V		6		pF
				1.2V		5		pF
				1.5V		5		pF
				1.8V		5		pF
				2.5V		5		pF
				3.3V		4		pF

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 パラメータ測定情報

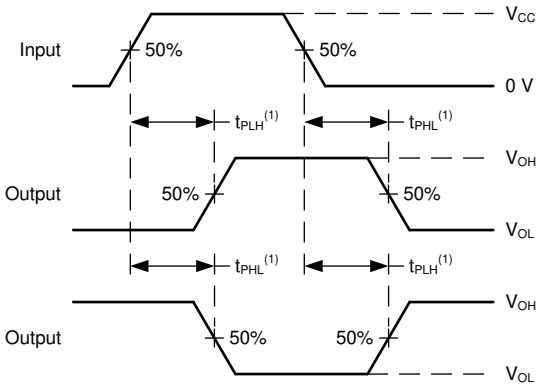
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、Z_O = 50Ω、t_t < 3ns。

出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。



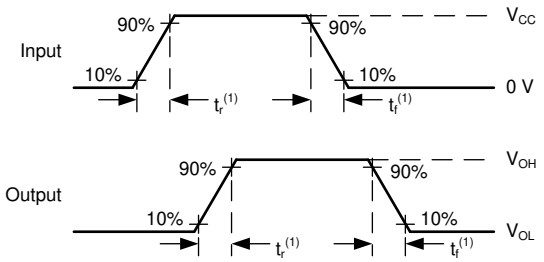
(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 6-1. プッシュプル出力のための負荷回路



(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きい方が t_{pd} に相当します。

図 6-2. 電圧波形、伝搬遅延



(1) t_r と t_f の大きい方が遷移時間に相当します。

図 6-3. 電圧波形、入力および出力の遷移時間

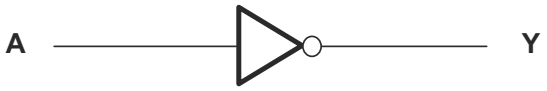
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7 詳細説明

7.1 概要

SN74UVP1G04 デバイスにはインバータ ゲートが内蔵されており、ブール関数 $Y = \overline{A}$ を実行します。このデバイスは I_{off} を使用することで、部分的パワーダウン アプリケーションに完全対応しています。I_{off} 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

7.2 機能ブロック図



7.3 機能説明

7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力

このデバイスには、平衡化された CMOS プッシュプル出力が内蔵されています。「平衡化」という用語は、デバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限します。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

未使用のプッシュプル CMOS 出力は、未接続のままにしておく必要があります。

7.3.2 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力が搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は*電気的特性*に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 (R = V ÷ I) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさなければ、消費電力が過剰になり、発振を引き起こす可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は V_{CC} または GND に終端させます。システムが常に入力を駆動していない場合は、有効な入力電圧を与えるために、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を追加することを検討してください。抵抗値は複数の要因によって異なりますが、推奨される値である 10kΩ を使用すれば、通常はすべての要件を満たすことができます。

7.4 デバイスの機能モード

機能表 に、SN74UVP1G04 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 A	出力 Y
H	L
L	H

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 使用上の注意

UVP ファミリは、バッテリー駆動のポータブル アプリケーションに対する低消費電力ニーズに応える最適ソリューションです。このファミリは、V_{CC} 範囲全体にわたって静的消費電力および動的消費電力を抑えることによりバッテリ寿命を延長します。また、この製品はシグナル インテグリティを良好に維持します。デバイスに小さなヒステリシスが内蔵されているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。駆動が低下するとエッジが低速になり、出力のオーバーシュートとアンダーシュートが防止されます。

8.2 代表的なアプリケーション

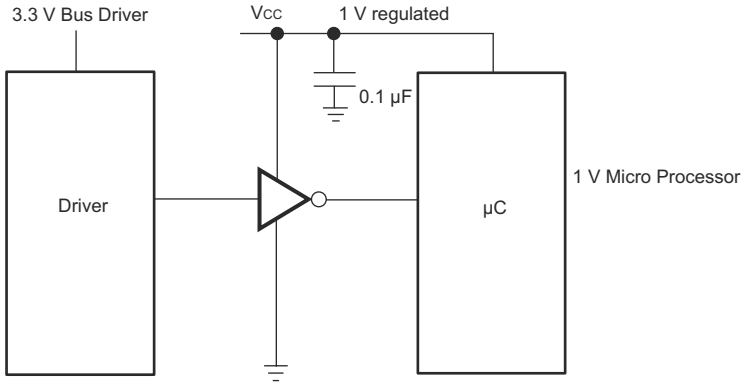


図 8-1. 代表的なアプリケーション回路図

8.2.1 設計要件

このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。バスコンテンションを避けるよう注意してください。バスコンテンションが発生すると、最大許容値を超える電流が発生する可能性があります。

8.2.2 詳細な設計手順

1. 推奨入力条件
   - 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様。(Δt/ΔV) を参照：*セクション 5.3*
   - High レベルと Low レベルを規定。(V_{IH} と V_{IL}) を参照：*セクション 5.3*
   - 入力は過電圧許容で、任意の有効な V_{CC} において最大 3.6 V に対応できます。
2. 推奨出力条件
   - 出力負荷電流は 20mA、部品全体の負荷電流は 50mA を超えないようにしてください。
   - 出力電圧を V_{CC} 以上に上げないでください。

8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置することを確認します。SN74UVP1G04 には、0.1µF バイパス コンデンサを推奨します。異なる周波数のノイズを除去するため、複数のバイパス コンデンサを並列に配置します。通常、0.1µF と 1µF の値のコンデンサを並列にして使います。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電気的に短いグランド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - 8mil～12mil のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する 12cm 未満の長さ
  - 信号トレースの 90° のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグランド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグランドでフラッド フィル
  - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
  - 12cm を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

8.4.2 レイアウト例

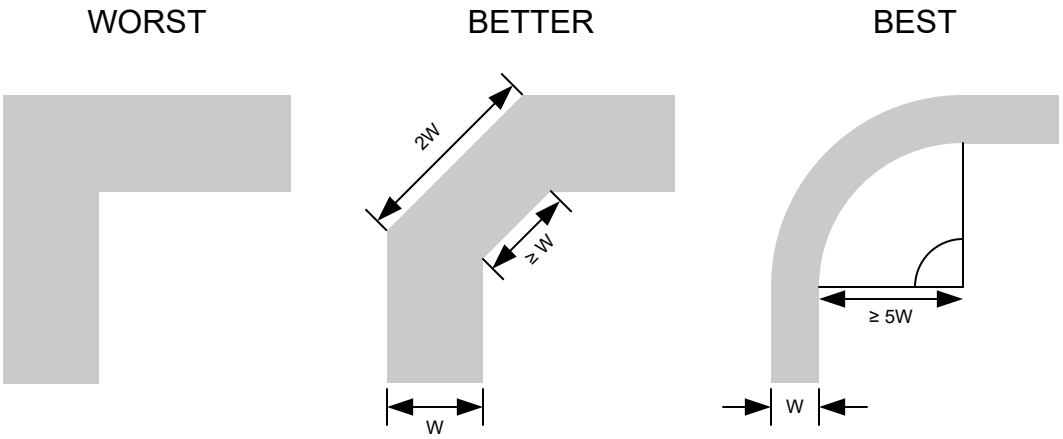


図 8-2. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

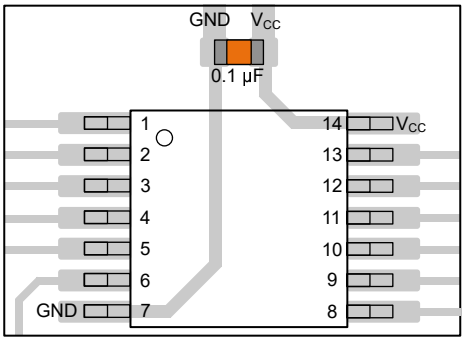


図 8-3. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

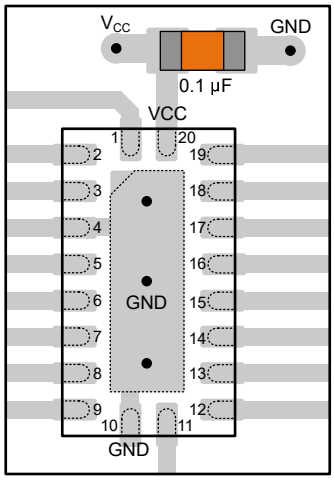


図 8-4. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

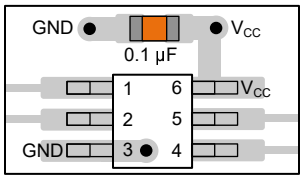


図 8-5. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

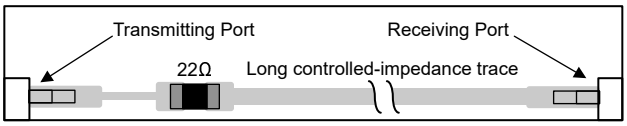


図 8-6. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントのサポート

9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『CMOS の消費電力と C_{pd} の計算』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『ロジック設計』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション ブリーフ
- テキサス・インスツルメンツ、『GTLP に重点を置いたライブ挿入アプリケーションでのロジック』アプリケーション ノート
- テキサス インスツルメンツ、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『テキサス・インスツルメンツの全般的品質ガイドライン』
- テキサス・インスツルメンツ、『SLL パッケージおよびデバイスの熱特性』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『シュミット トリガについて』アプリケーション ブリーフ

9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (August 2026) to Revision A (October 2026)	Page
• ドキュメントのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更	1

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側のナビゲーションをご覧ください。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PSN74UVP1G04DBVR	Active	Preproduction	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PSN74UVP1G04DCKR	Active	Preproduction	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PSN74UVP1G04DPWR	Active	Preproduction	X2SON (DPW) | 5	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PSN74UVP1G04DRYR	Active	Preproduction	SON (DRY) | 6	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PSN74UVP1G04DSFR	Active	Preproduction	SON (DSF) | 6	3000 | LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74UVP1G04 :

- Automotive : SN74UVP1G04-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

GENERIC PACKAGE VIEW

DPW 5 X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

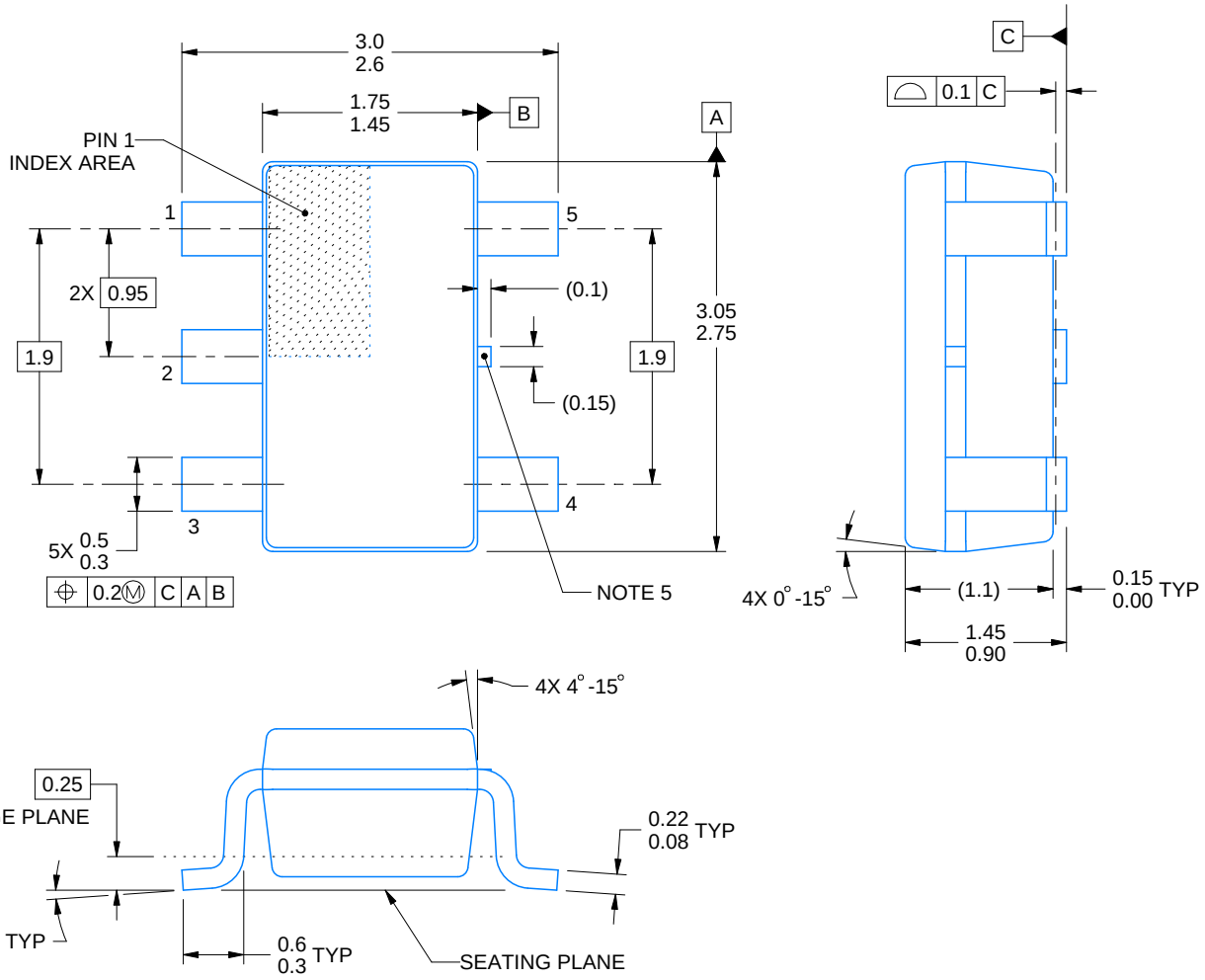
4211218-3/D

PACKAGE OUTLINE

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

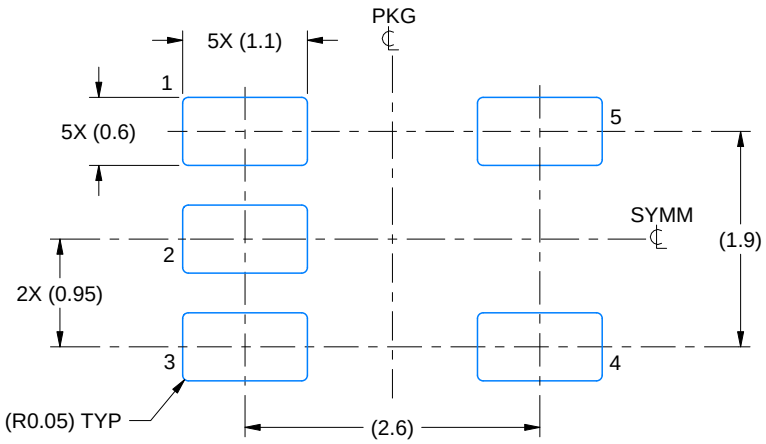
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



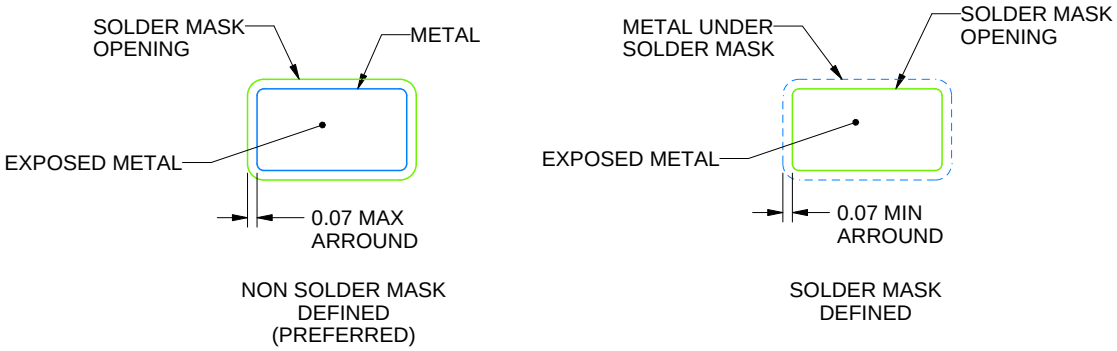
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

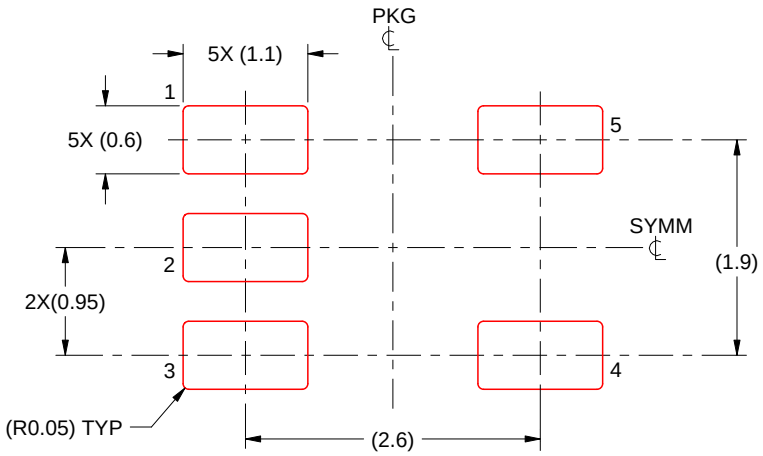


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

DRY 6 USON - 0.6 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



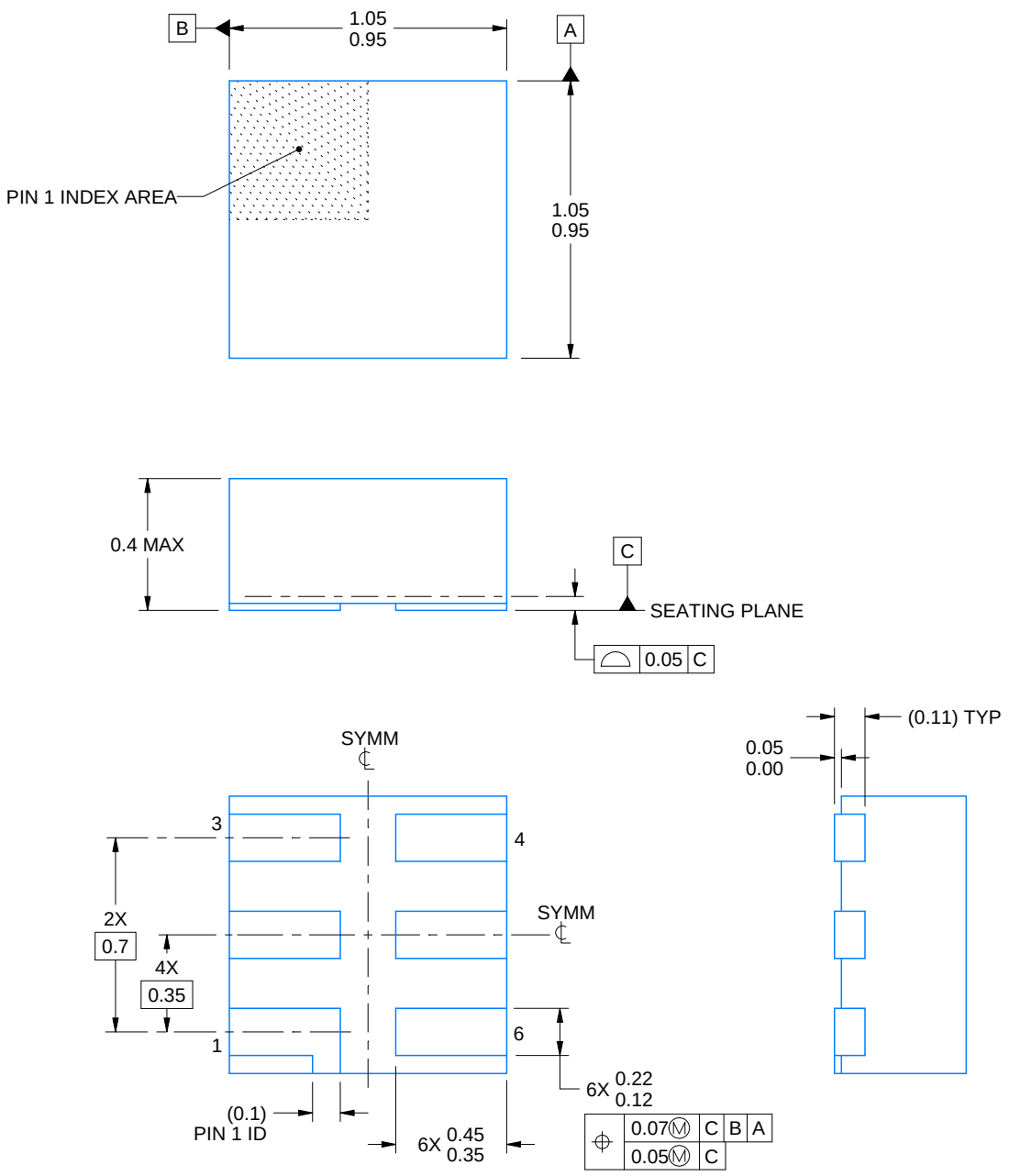
Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

PACKAGE OUTLINE

DSF0006A

X2SON - 0.4 mm max height

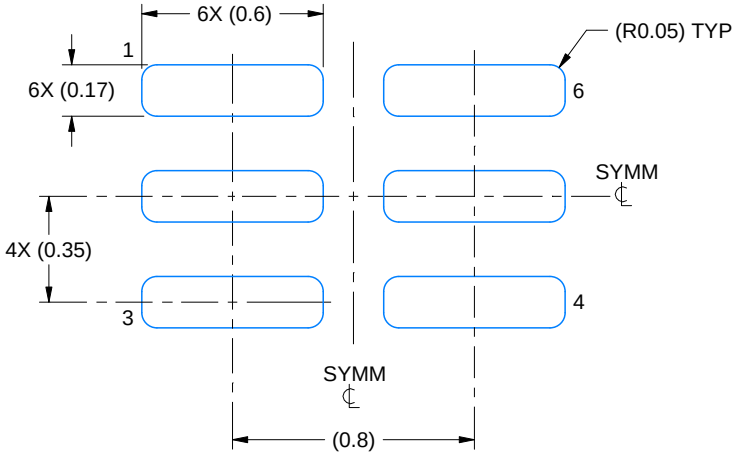
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



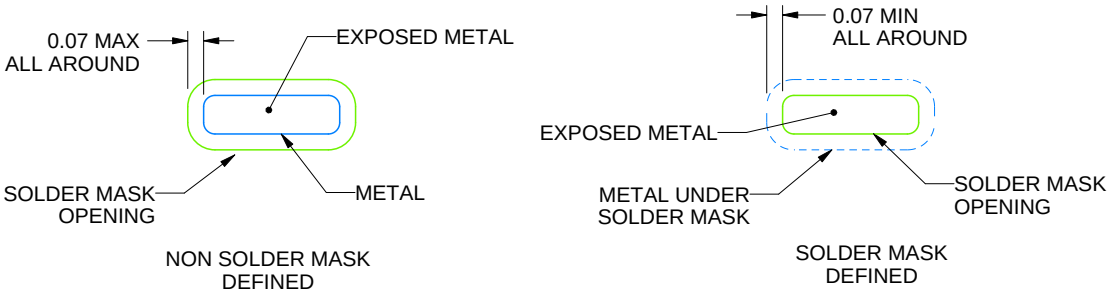
4220597/B 06/2022

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration MO-287, variation X2AAF.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:40X



SOLDER MASK DETAILS

4220597/B 06/2022

NOTES: (continued)

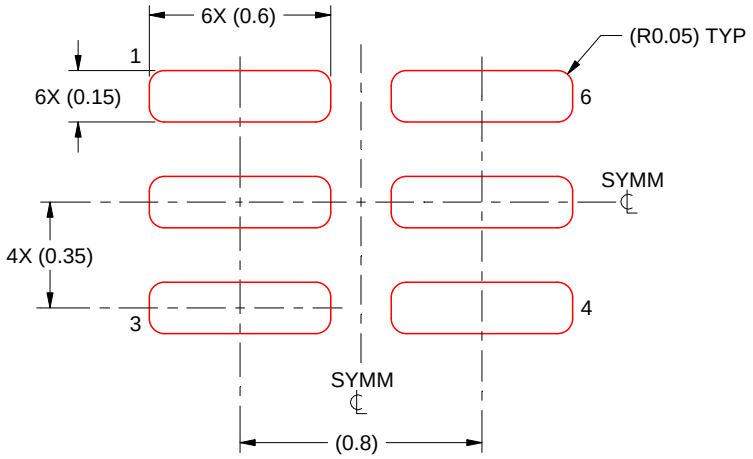
4. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DSF0006A

X2SON - 0.4 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.09 mm THICK STENCIL

PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:40X

4220597/B 06/2022

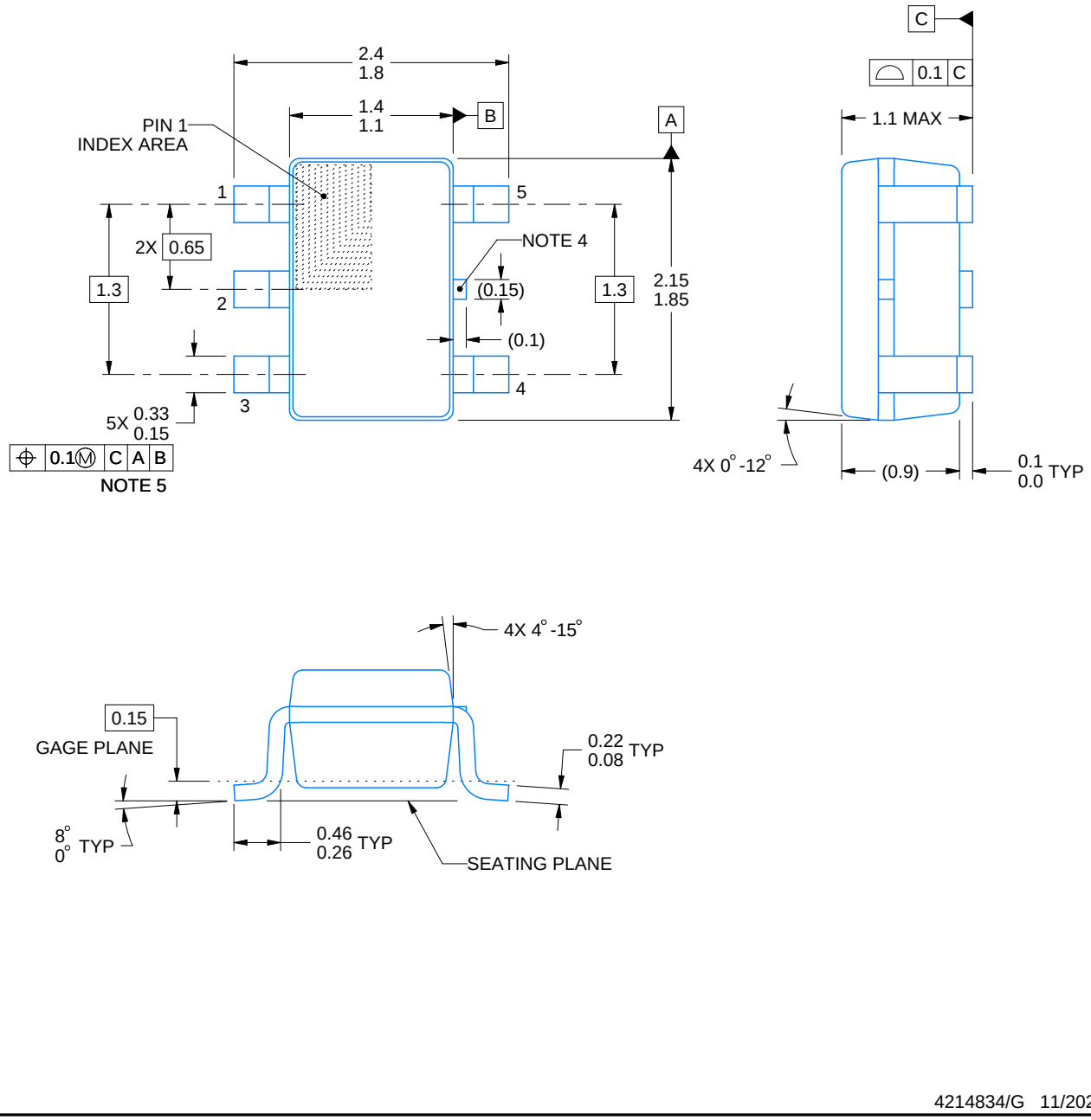
4. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGE OUTLINE

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

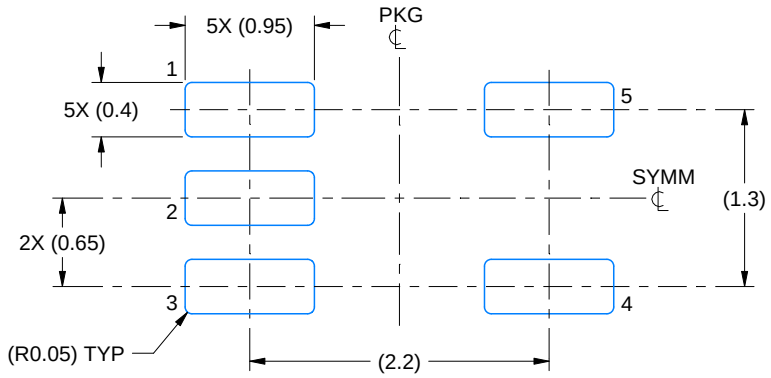
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



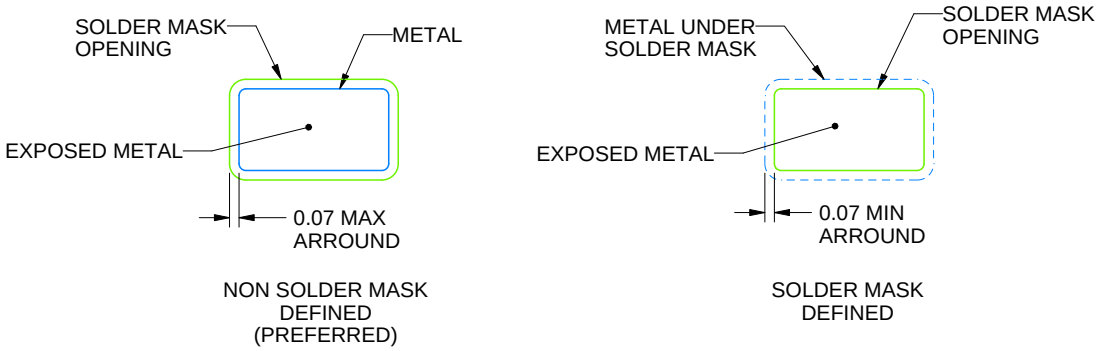
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

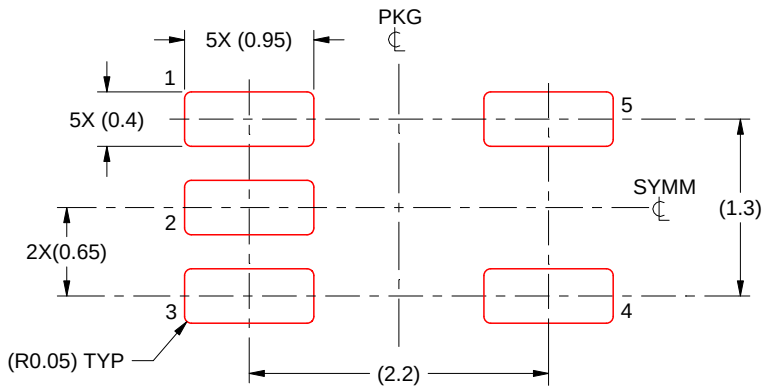


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月